

(19)



(11)

EP 3 382 744 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

03.10.2018 Patentblatt 2018/40

(51) Int Cl.:

H01L 21/20 (2006.01)

B23P 19/00 (2006.01)

H01L 21/67 (2006.01)

H01L 21/66 (2006.01)

H01L 25/00 (2006.01)

H01L 21/18 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **18166536.5**

(22) Anmeldetag: **16.02.2016**

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

• **Plach, Thomas**

4782 St. Florian am Inn (AT)

• **SÜSS, Jürgen Markus**

4791 Rainbach b. Schärding (AT)

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:

16705484.0 / 3 227 907

(74) Vertreter: **Schneider, Sascha et al**

Becker & Müller

Patentanwälte

Turmstraße 22

40878 Ratingen (DE)

(71) Anmelder: **EV Group E. Thallner GmbH**

4782 St. Florian am Inn (AT)

(72) Erfinder:

• **Kurz, Florian**

4775 Taufenkirchen/Pram (AT)

• **WAGENLEITNER, Thomas**

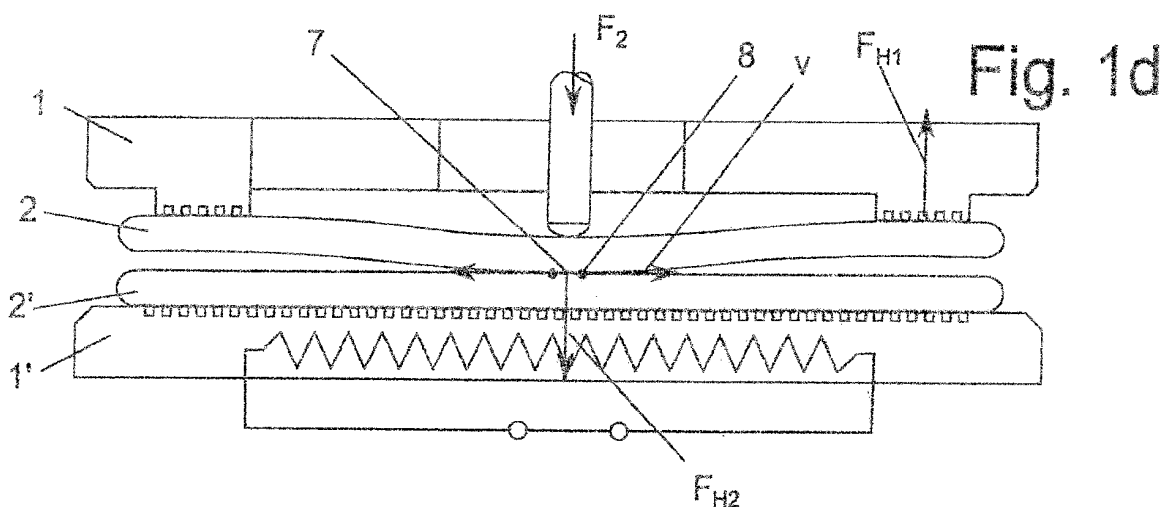
4971 Auroldmünster (AT)

Bemerkungen:

Diese Anmeldung ist am 10-04-2018 als
Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten
Anmeldung eingereicht worden.

(54) **VORRICHTUNG ZUM BONDEN VON SUBSTRATEN**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bonden eines ersten Substrats (2) mit einem zweiten Substrat (2').



EP 3 382 744 A1